

半導体・生成AI製造工程領域へのプロジェクト始動

当社は、成長が続く半導体および生成AI関連市場において、製造工程領域への取組みをより加速させるためプロジェクトを始動いたしました。

これまで自動車・FA・工作機械分野で培ってきた技術基盤を活かし、半導体デバイスおよび生成AI関連デバイスの製造工程において、高精度化・微細化・生産性向上・省電力化に貢献する提案を推進しています。

装置提供にとどまらず、事前検証から量産立上げまで一貫して対応し、工程全体の最適化に貢献してまいります。

背景・狙い WHY

- 自動車・FA・工作機械で培った技術力を半導体分野へ展開
- 生成AI需要拡大に伴う後工程の高度化ニーズに対応
- 技術商社として装置+エンジニアリングの一括提案が可能

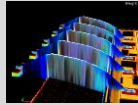
半導体デバイス成長による
売上拡大のイメージ

10% → 30%



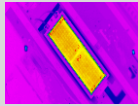
半導体後工程

ダイシング / ボンディング / パッケージング
外観検査 / マーキング



生成AIデバイス製造工程

HBM / 先端PKGLレーザー加工
高密度接合 / 高精度検査



- 自動車・FA・工作機械（既存市場）
- 半導体関連市場

導入実績 TRACK RECORD



国内大手メーカー
複数社との取引実績



半導体関連企業への
装置導入実績



量産ライン対応
豊富な稼働経験

半導体関連取引先：イビデン/キャノン/デンソー/村田製作所/ローム/Rapidus など

強み・差別化 WHY US



技術商社の総合提案力

装置選定から工程設計まで
メーカー横断で最適構成を提案



異分野ノウハウの転用

自動車・FA・工作機械で蓄積した
高精度加工・検査技術を半導体へ展開

ソリューション HOW



装置・技術提供

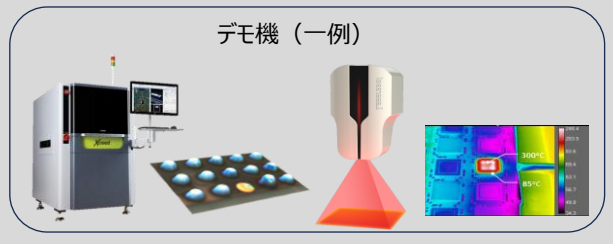


デモ機による検証



カスタム装置製作
製品開発

デモ機（一例）



提供価値 WHAT



高精度化



微細化



生産性向上



省電力化



高信頼性